

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2003254459 A

(43) Date of publication of application: 10.09.03

(51) Int. CI

F16K 23/00 // F16K 7/07

(21) Application number: 2002060085

(22) Date of filing: 06.03.02

(71) Applicant:

SMC CORP

(72) Inventor:

FUKANO YOSHIHIRO UCHINO TADASHI

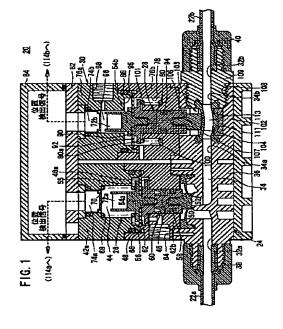
(54) SUCK BACK VALVE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent the generation of a liquid reservoir and the accumulation of dust and the like, and to establish minute sucking amount.

SOLUTION: This such back valve comprises: a deformable cylindrical flexible member 104 formed with a flowing chamber 102 communicating a divided fluid passage 34a in a first port 32a side and a fluid passage 34b in a second port 32b side inside; a fixing member 113 fixing a part of an outer peripheral surface of the cylindrical flexible member 104 to a joint portion 24; and a hook member 106 increasing the capacity of the flowing chamber 102 by tensing and deforming the outer peripheral surface of the cylindrical flexible member 104.

COPYRIGHT: (C)2003,JPO



(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-254459 (P2003-254459A)

(43)公開日 平成15年9月10日(2003.9.10)

(51) Int.Cl.7

(22)出願日

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

F16K 23/00

#F16K 7/07

F16K 23/00

7/07

Z

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 9 頁)

特願2002-60085(P2002-60085) (21)出願番号

平成14年3月6日(2002.3.6)

(71)出願人 000102511

SMC株式会社

東京都港区新橋1丁目16番4号

(72)発明者 深野 喜弘

茨城県筑波郡谷和原村絹の台4-2-2

エスエムシー株式会社筑波技術センター内

(72) 発明者 内野 正

茨城県筑波郡谷和原村絹の台4-2-2

エスエムシー株式会社筑波技術センター内

(74)代理人 100077665

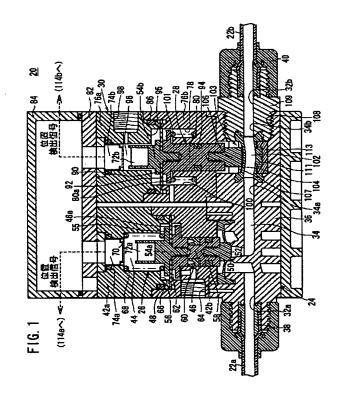
弁理士 千葉 剛宏

(54) 【発明の名称】 サックパックパルプ

(57)【要約】

【課題】液溜まりの発生や塵埃等が集積することを防止 するとともに、微小なサック量を設定することにある。

【解決手段】分断された第1ポート32a側の流体通路 34 aと第2ポート32b側の流体通路34bとを連通 させる流通室102が内部に形成された変形自在な円筒 状可撓性部材104と、前記円筒状可撓性部材104の 外周面の一部を継手部24に固定する固定部材113 と、前記円筒状可撓性部材104の外周面を引張して変 形させることにより前記流通室102の容積を増大させ るフック部材106とを備える。



【特許請求の範囲】

【請求項1】一端部に形成された第1ポートと他端部に 形成された第2ポートとを連通させる流体通路が設けら れた本体部と、

1

弁体が変位することにより、前記流体通路を開閉するオ

分断された前記流体通路の間に介装され、前記分断され た第1ポート側の流体通路と前記第2ポート側の流体通 路とを連通させる流通室が内部に形成された変形自在な 可撓性部材と、

前記可撓性部材の外周面の一部を本体部に固定する固定 部材と、

前記可撓性部材の外周面を引張して変形させることによ り前記流通室の容積を増大させる引張部材と、

前記引張部材に連結され、該引張部材を変位させる変位 部材と、

を備え、前記可撓性部材の負圧作用下によって前記流体 通路内の圧力流体を吸引することを特徴とするサックバ ックバルブ。

【請求項2】請求項1記載のサックバックバルブにおい て、

前記引張部材は、円筒状の可撓性部材の外周面に係合す る断面円弧状のスリーブを有するフック部材からなるこ とを特徴とするサックバックバルブ。

【請求項3】請求項1記載のサックバックバルブにおい て、

前記変位部材は、パイロット圧の作用下に変位するピス トンからなることを特徴とするサックバックバルブ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、流体通路を流通す る所定量の圧力流体を吸引することにより、例えば、圧 力流体の供給口の液だれを防止することが可能なサック バックバルブに関する。

[0002]

【従来の技術】従来から、例えば、半導体ウェハ等の製 造工程においてサックバックバルブ(suck back valv e) が使用されている。このサックバックバルブは、半 導体ウェハに対するコーティング液の供給を停止した 際、供給口から微量のコーティング液が半導体ウェハに 向かって滴下する、いわゆる液だれを防止する機能を有

【0003】ここで、この種の従来技術に係るサックバ ックバルブを図9に示す(特公平6-47092号公報 参照)。

【0004】このサックバックバルブ1は、流入口2と 流出口3とを連通させる流通室4が形成された本体5 と、前記本体5の上部に連結されるカバー6とを有す る。なお、前記流入口2は、被吐出液体の供給源(図示 ルに接続されている。

【0005】前記流通室4の略中央には上方に向かって 延在する開口部7が形成され、前記開口部7には該流通 室4の上面を気密に仕切る第1ダイアフラム8が張設さ れている。前記第1ダイアフラム8の上方に形成された 収納室 9 内には、下端部を前記第1 ダイアフラム 8 に当 接させた昇降部材10が配置される。

【0006】前記昇降部材10の上部側には、本体5と カバー6との間に挟持された第2ダイアフラム11が配 10 設され、該昇降部材10の端部に加締め付けられて第2 ダイアフラム11に固着された突出部12によって前記 第2ダイアフラム11と昇降部材10とが一体的に変位 するように設けられている。

【0007】第1ダイアフラム8と第2ダイアフラム1 1との間には、前記第2ダイアフラム11を上方に向か って付勢するコイルばね13が装着されている。また、 第2ダイアフラム11とカバー6との間には、パイロッ トエアポート14を介してパイロットエアが供給される 圧力室15が形成されている。さらに、カバー6には、 昇降部材10の突出部12に当接する検出ピン16を備 える検出装置17が設けられている。

【0008】この従来技術に係るサックバックバルブ1 の概略動作を説明すると、被吐出液体の供給中は、図示 しない電空比例弁からパイロットエアポート14に供給 される圧力室15の圧力が高く、第2ダイアフラム11 がコイルばね13のばね力に打ち勝って図9中の二点鎖 線で示す下方位置にあり、昇降部材10と一体的に作動 する第1ダイアフラム8も下方位置にあって流通室4の 容積が小さくなっている。

【0009】そこで、被吐出液体の供給源を滅勢させて ノズルからの吐出を停止させると、パイロットエアポー ト14から供給されるパイロット圧が低減し、圧力室1 5内の圧力が低下する。従って、第2ダイアフラム11 および昇降部材10とともに第1ダイアフラム8が一体 的に上昇し、図9中の実線で示す状態となる。この結 果、第1ダイアフラム8が変形して流通室4の容積が増 大することにより、ノズル内の被吐出液が吸引される。 【0010】この場合、第1ダイアフラム8の変形は昇

降部材10の上下動作と対応するものであり、これを検 40 出装置17の検出ピン16の動きとして検知し、検出装 置17から図示しない指令装置に検出信号が導出されて フィードバック制御がなされる。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記の 従来技術に係るサックバックバルブでは、第1ダイアフ ラムを変形(撓曲)させて流通室の容積を増大させるこ とにより、ノズル内に残存する被吐出液体を吸引する方 法が採用されており、前記第1ダイアフラムの変形に伴 って該第1ダイアフラムの周緑部が挟持されている開口 せず)に接続され、一方、流出口3は、図示しないノズ 50 部周辺に液溜まりが発生するおそれがある。また、被吐

30

3

出液体中に含まれる塵埃やノズル内の塵埃が第1ダイアフラムの吸引作用下に前記開口部周辺に集積するおそれがある。

【0012】さらに、従来技術に係るサックバックバルブでは、第1ダイアフラムの変形量に対応して被吐出液体のサック量が設定されているが、微小なサック量を設定することができないという不具合がある。なぜならば、従来技術に係るサックバックバルブでは、微小なサック量を設定する場合、第1ダイアフラムの変形量を小さくするために、前記第1ダイアフラムが装着された開口部の口径をできるだけ小さく形成する必要があるが、製造上、開口部の口径の縮径化に限界があるからである。

【0013】本発明は、前記の不具合等を考慮してなされたものであり、液溜まりの発生や塵埃の集積等を防止するとともに、微小なサック量を設定することが可能なサックバックバルブを提供することを目的とする。

[0014]

【課題を解決するための手段】前記の目的を達成するために、本発明は、一端部に形成された第1ポートと他端 20部に形成された第2ポートとを連通させる流体通路が設けられた本体部と、弁体が変位することにより、前記流体通路を開閉するオン/オフ弁と、分断された前記流体通路の間に介装され、前記分断された第1ポート側の流体通路と前記第2ポート側の流体通路とを連通させる流通室が内部に形成された変形自在な可撓性部材と、前記可撓性部材の外周面を引張して変形させることにより前記流通室の容積を増大させる引張部材と、前記引張部材に連結され、該引張部材を変位させる変位部材と、を備え、前記可撓性部材の負圧作用下によって前記流体通路内の圧力流体を吸引することを特徴とする。

【0015】この場合、前記引張部材を、円筒状の可撓性部材の外周面に係合する断面円弧状のスリーブを有するフック部材によって形成し、前記変位部材を、パイロット圧の作用下に変位するピストンによって形成するとよい。

【0016】本発明によれば、引張部材を変位部材と一体的に変位させ、前記引張部材によって可撓性部材の外周面を引張して変形させることにより前記流通室の容積 40 を増大させることができる。従って、流通室の容積の増大に伴って負圧作用が発生し、流体通路内の圧力流体が吸引される。

【0017】この場合、可撓性部材の内部には第1ポート側の流体通路と第2ポート側の流体通路とを連通させる流通室が形成され、前記可撓性部材は分断された流体通路の間に変形自在に介装されているため、前記流通室を増減変更させても液溜まりの発生や塵埃等の集積を防止することができる。

[0018]

【発明の実施の形態】本発明に係るサックバックバルブ について好適な実施の形態を挙げ、添付の図面を参照し ながら以下詳細に説明する。

【0019】図1において参照数字20は、本発明の実施の形態に係るサックバックバルプを示す。このサックバックバルプ20は、一組のチューブ22a、22bが着脱自在に所定間隔離間して接続される継手部24と、前記継手部24の上部に設けられ内部にオン/オフ弁26およびサックバック機構28を有する弁駆動部30とを有する。

【0020】前記継手部24には、一端部に第1ポート32aが、他端部に第2ポート32bが形成されるとともに、前記第1ポート32aと第2ポート32bとを連通させる流体通路34が設けられた継手ボデイ36と、前記第1ポート32aおよび第2ポート32bにそれぞれ係合し、且つチューブ22a、22bの開口部に挿入されるインナ部材38と、前記継手ボデイ36の端部に刻設されたねじ溝に螺入することによりチューブ22a、22bの接続部位の液密性または気密性を保持するロックナット40とを有する。

【0021】第1ポート32aに近接する継手部24の 上部にはオン/オフ弁26が配設され、前記オン/オフ 弁26は、継手ボデイ36と一体的に連結された第1上 部側弁ボデイ42aおよび第1下部側弁ボデイ42b と、前記第1上部側弁ボデイ42 a および第1下部側弁 ボデイ42bの内部に形成された第1室44内に配設さ れ、上下方向に沿って変位自在に設けられた第1ピスト ン46とを有する。なお、前記第1上部側弁ボデイ42 aと第1下部側弁ボデイ42bとの連結部位には、第1 30 シール部材48が装着され、前記第1シール部材48の シール作用によって第1室44の気密性が保持される。 【0022】前記第1ピストン46の軸線方向に沿った 一端部には、着座部50に着座することにより流体通路 34を閉塞する弁体52がねじ締結され、前記弁体52 は、中央の厚肉部と該厚肉部の周辺部に一体的に形成さ れた薄肉部とから構成される。前記第1ピストン46の 軸線方向に沿った他端部には、ねじ部を介して第1連結 部材54 aが締結され、該第1ピストン46と第1連結 部材54aとの連結部位には第1ダイアフラム56が挟 持される。前記第1ダイアフラム56は、薄肉の平板状 に形成され、その周縁部が第1上部側弁ボデイ42 a お よび第1下部側弁ボデイ42bによって挟持される。前 記第1ピストン46の外周面には、環状溝を介してOリ ング58と断面V字状のパッキン60とがそれぞれ装着

【0023】前記第1ダイアフラム56の下部側には、 該第1ダイアフラム56によって気密に閉塞されたシリンダ室62が形成され、前記シリンダ室62に連通する 第1圧力流体出入ポート64を介して該シリンダ室62 のに圧力流体が供給される。前記圧力流体は、第1ピス トン46の上部側に形成されたフランジ部46aに作用し、前記第1ピストン46を上方に向かって押圧する。従って、第1ダイアフラム56の撓曲作用下に、第1連結部材54a、第1ピストン46および弁体52が一体的に上昇することにより、弁体52が着座部50から離間して弁閉状態から弁開状態に切り換わる(図7参照)。

【0024】なお、図7に示されるように、前記第1連結部材54aの半径外方向に向かって突出するフランジ部55が第1上部側弁ボデイ42aの壁面66に当接することにより、上方側に対する変位が規制される。

【0025】第1室44内には一端部が前記第1連結部材54aのフランジ部55に係着され、他端部が第1上部側弁ボデイ42aの環状段部68に係着された第1ばね部材70が設けられる。前記第1ばね部材70のばね力によって、第1連結部材54a、第1ピストン46および弁体52が下方側に向かって押圧されるように設けられている。

【0026】また、前記第1連結部材54aの一端部には、凹部を介して第1磁石72aが装着されている。な 20 お、前記フランジ部55は、第1上部側弁ボデイ42a の環状段部68に当接することにより、第1ピストン46の上昇を規制するストッパとして機能するものである。

【0027】所定距離離間して前記第1磁石72aと対向する第1上部側弁ボデイ42aには、例えば、ホール素子等からなり、第1ピストン46の位置を検出する第1位置検出センサ74aが設けられる。この場合、前記第1位置検出センサ74aが第1連結部材54aの一端部に装着された第1磁石72aの磁界を検知することに 30より、オン/オフ弁26の弁開状態または弁閉状態をそれぞれ検出し、図示しないリード線およびコネクタを介して位置検出信号を後述する第1コントロールユニット(図6参照)に導出することができる。

【0028】第2ポート32bに近接する継手部24の 上部にはサックバック機構28が配設され、前記サック バック機構28は、継手ボデイ36と一体的に連結され た第2上部側弁ボデイ76aおよび第2下部側弁ボデイ 76bと、前記第2上部側弁ボデイ76aおよび第2下 部側弁ボデイ76bの内部に形成された第2室78内に 40 配設され、上下方向に沿って変位自在に設けられた第2 ピストン(変位部材)80とを有する。

【0029】オン/オフ弁26の第1上部側弁ボデイ42a、第1下部側弁ボデイ42bおよびサックバック機構28の第2上部側弁ボデイ76a、第2下部側弁ボデイ76bは、それぞれ、共通に搭載されるボンネット82およびカバー部材84によって一体的に組み付けられる。なお、前記第2上部側弁ボデイ76aと第2下部側弁ボデイ76bとの連結部位には、第2シール部材86が装着され、前記第2シール部材86のシール作用によ50

って第2室78の気密性が保持される。

【0030】前記第2ピストン80の上面部には、ねじ部を介して第2連結部材54bが締結され、該第2ピストン80と第2連結部材54bとの間には、第2上部側弁ボデイ76aおよび第2下部側弁ボデイ76bによって周縁部が挟持された薄肉平板状の第2ダイアフラム92が介装される。前記第2ピストン80の外周面には、環状溝を介してOリング94が装着される。なお、図7に示されるように、前記第2連結部材54bの半径外方向に向かって突出するフランジ部90が第2上部側弁ボデイ76aの壁面95に当接することにより、上方側に対する変位が規制される。また、前記第2連結部材54bの一端部には、凹部を介して第2磁石72bが装着されている。

【0031】所定距離離間して前記第2磁石72bと対向する第2上部側弁ボデイ76aには、例えば、ホール素子等からなり、第2ピストン80の位置を検出する第2位置検出センサ74bが設けられる。この場合、前記第2位置検出センサ74bが第2連結部材54bの一端部に装着された第2磁石72bの磁界を検知することにより、第2ピストン80の変位状態をそれぞれ検出し、図示しないリード線およびコネクタを介して位置検出信号を後述する第1コントロールユニット114a(図6参照)に導出することができる。

【0032】前記第2ダイアフラム92の上部側には、該第2ダイアフラム92によって気密に閉塞されたダイアフラム室96が形成され、前記ダイアフラム室96に連通する第2圧力流体出入ポート98を介して該ダイアフラム室96内に圧力流体(パイロット圧)が供給される。

【0033】また、前記第2ダイアフラム92の下部側には、第2ピストン80の直径よりも大きな直径からなる環状溝100が形成され、前記環状溝100内には、一端部が第2ピストン80のフランジ部80aに係着され他端部が前記環状溝100の底面部に係着され、該第2ピストン80を上方に向かって押圧する第2ばね部材101が配設されている。

【0034】前記第2ピストン80の下部側には、流体通路34に連通する流通室102の容積を増減変更させる容積可変機構103が設けられる。

【0035】この容積可変機構103は、分断された流体通路34a、34bの間に略同軸状に装着され、分断されたそれぞれの流体通路34a、34bに連通する流通室102が形成された円筒状可撓性部材104と、前記円筒状可撓性部材104の外周面の一部を囲繞する断面略円弧状のスリーブ105(図3参照)が形成され、ねじ部105aを介して第2ピストン80の下部に連結されたフック部材(引張部材)106とを有する。

【0036】前記円筒状可撓性部材104は、維手ボデイ36の切り欠かれた凹部107内に配置され、その一

れる。

7

場部が継手ボデイ36 側に固着され他端部が前記継手ボデイ36の孔部108に嵌合される嵌合部材109 側に固着される。また、前記円筒状可撓性部材104の下部側には、軸線方向に沿って延在する突条部111が形成され、前記突条部111が前記凹部107に固着された固定部材113によって固定されている。なお、前記円筒状可撓性部材104は、例えば、テトラフルオロエチレンパーフルオロアルキルビニルエーテルコポリマー

(PFA) またはポリテトラフルオロエチレン (PTFE) 等の樹脂製材料によって形成すると好適である。

【0037】さらに、前記円筒状可撓性部材104の内部には、軸線方向に沿った一端部および他端部が第1ポート32a側の流体通路34aおよび第2ポート32b側の流体通路34bにそれぞれ連通する流通室102が形成され、前記第2ピストン80と一体的にフック部材106が上昇することにより、断面略円弧状のスリーブ105の先端部が円筒状可撓性部材104の外周面の一部に係合し、該円筒状可撓性部材104の上部側が上方に向かって引き上げられる。このように、フック部材106のスリーブ105が上昇して円筒状可撓性部材104の外周面の一部が上方に向かって引張され、前記円筒状可撓性部材104が変形して伸張することにより、内部に形成された流通室102の容積が増大する(図4および図5参照)。

【0038】なお、前記流通室102の内部の下部側断面を湾曲面115に形成することにより、該流通室102の容積変化を大きくさせることができるという利点がある

【0039】この場合、第2圧力流体出入ポート98を通じてダイアフラム室96内に供給された圧力流体が第2ダイアフラム92の上面部に作用して該第2ダイアフラム92を下方側に向かって押圧する。従って、第2ピストン80およびフック部材106は、第2ばね部材101のばね力に抗して一体的に下方側に変位し、前記フック部材106のスリーブ105が円筒状可撓性部材104を下方側に押圧して流通室102の容積が減少した状態にある。

【0040】本発明の実施の形態に係るサックバックバルブ20は、基本的には以上のように構成されるものであり、次にその動作並びに作用効果について説明する。【0041】図6は、本実施の形態に係るサックバックバルブ20が組み込まれたサックバックシステム110を示す。

【0042】このサックバックシステム110は、略同一構成からなり、入力された電気信号に対応する空気圧信号を出力する第1および第2電空比例弁112a、112bは、それぞれ、第1および第2コントロールユニット(制御手段)114a、114bと、前記第1および第2コントロールユニット(114b)

それぞれ出力される指令信号(オン信号/オフ信号)に基づいて付勢・滅勢されるノーマルクローズタイプの供給用電磁弁116および排気用電磁弁118とを含む。また、前記第1および第2電空比例弁112a、112bには、第1および第2コントロールユニット114a、114bに対して設定信号を導入する第1および第2データ設定手段120a、120bがそれぞれ接続さ

【0043】この場合、第1電空比例弁112aを構成10 する供給用電磁弁116と排気用電磁弁118との間の連通路から分岐する通路122がオン/オフ弁26の第1圧力流体出入ポート64に接続され、一方、第2電空比例弁112bを構成する供給用電磁弁116と排気用電磁弁118との間の連通路から分岐する通路124がサックバック機構28の第2圧力流体出入ポート98に接続されている。

【0044】なお、前記第1および第2コントロールユニット114a、114bには、制御・判断・処理・演算・記憶の各手段として機能する図示しないMPU(マイクロプロセッサユニット)が設けられ、該MPUから導出される制御信号によって供給用電磁弁116および/または排気用電磁弁118を付勢・滅勢することにより、オン/オフ弁26のシリンダ室62とサックバック機構28のダイアフラム室96にそれぞれ供給されるパイロット圧が制御される。

【0045】また、オン/オフ弁26の第1位置検出センサ74aは第1コントロールユニット114aと電気的に接続され、前記第1位置検出センサ74aの位置検出信号が第1コントロールユニット114aに導入される。一方、サックバック機構28の第2位置検出センサ74bは、第2コントロールユニット114bと電気的に接続され、前記第2位置検出センサ74bの位置検出信号が第2コントロールユニット114bに導入される。

【0046】なお、サックバックバルブ20の第1ポート32aに連通するチューブ22aには、コーティング液が貯留されたコーティング液供給源123を接続し、一方、第2ポート32bに連通するチューブ22bには図示しない半導体ウェハに向かってコーティング液を滴下するノズルが設けられたコーティング液滴下装置125を接続しておく。

【0047】このような準備作業を経た後、圧力流体供給源126を付勢して第1および第2電空比例弁112 a、112bに対して圧力流体を導入するとともに、データ設定手段120a、120bを介して第1および第2コントロールユニット114a、114bに設定信号を導入する。第1コントロールユニット114aは、前記設定信号に基づいて供給用電磁弁116にのみ付勢信号を導出し、供給用電磁弁116をオン状態とする。そ50 の際、排気用電磁弁118は滅勢されてオフ状態にあ

る。従って、供給用電磁弁116を介してオン/オフ弁 26に導入されるパイロット圧がシリンダ室62に供給 されて第1ピストン46が上昇することにより、オン/ オフ弁26がオン状態となる。

【0048】その際、第1ピストン46の一端部に装着 された第1磁石72aの磁界を第1位置検出センサ74 aによって検知し、前記第1位置検出センサ74aから 導出される位置検出信号が第1コントロールユニット1 14 aに導入されることにより、第1コントロールユニ ット114aは、オン/オフ弁26がオン状態となった ことを確認する。

【0049】一方、第2コントロールユニット114b は、前記設定信号に基づいて供給用電磁弁116にのみ 付勢信号を導出し、供給用電磁弁116をオン状態とす る。その際、排気用電磁弁118は滅勢されてオフ状態 にある。従って、供給用電磁弁116を介してサックバ ック機構28に導入されるパイロット圧がダイアフラム 室96に供給されて第2ダイアフラム92を押圧するこ とにより、第2ばね部材101のばね力に抗して第2ピ ストン80およびフック部材106が下方側に向かって 変位し、前記フック部材106の湾曲したスリーブ10 5が円筒状可撓性部材104を下方側に向かって押圧し た状態となる。

【0050】その際、第2ピストン80の一端部に装着 された第2磁石72bの磁界を第2位置検出センサ74 bによって検知し、前記第2位置検出センサ74bから 導出される位置検出信号が第2コントロールユニット1 14 bに導入されることにより、第2コントロールユニ ット114bは、第2ピストン80およびフック部材1 06が下方側に変位した状態となったことを確認する。 【0051】このようにオン/オフ弁26がオン状態に あり、且つフック部材106のスリーブ105の押圧作 用によって円筒状可撓性部材104の流通室102の容 積が減少した状態において、コーティング液供給源12 3から供給されたコーティング液は、流体通路34およ び流通室102に沿って流通し、コーティング液滴下装 置125を介してコーティング液が半導体ウェハに滴下 される。この結果、半導体ウェハには、所望の膜厚を有 するコーティング被膜 (図示せず) が形成される。

【0052】コーティング液滴下装置125を介して所 定量のコーティング液が図示しない半導体ウェハに塗布 された後、第1コントロールユニット114aの図示し ないMPUから導出される制御信号によって供給用電磁 **弁116および/または排気用電磁弁118を適宜付勢** ・滅勢することにより、オン/オフ弁26のシリンダ室 62に供給されるパイロット圧を減少させ、オン/オフ 弁26をオフ状態とする。

【0053】すなわち、オン/オフ弁26のシリンダ室 62に供給されるパイロット圧が減少して零となること により、第1ばね部材70のばね力の作用下に第1ピス 50 から導出される位置検出信号が第2コントロールユニッ

トン46が下方側に向かって変位し、弁体52が着座部 50に着座する。なお、第1ピストン46と一体的に変 位する第1磁石72aの磁界を第1位置検出センサ74 aによって検知し、前記位置検出信号を第1コントロー ルユニット114aに導入することにより、第1コント ロールユニット114aはオン/オフ弁26がオフ状態 となったことを確認する。

【0054】従って、オン/オフ弁26がオフ状態とな って流体通路34が遮断されることにより半導体ウェハ に対するコーティング液の供給が停止し、コーティング 液滴下装置125の図示しないノズルから半導体ウェハ に対するコーティング液の滴下状態が停止する。この場 合、コーティング液滴下装置125のノズル内には、半 導体ウェハに滴下される直前のコーティング液が残存し ているため、液だれが生ずるおそれがある。

【0055】そこで、第2コントロールユニット114 bは、第2電空比例弁112bの供給用電磁弁116に 滅勢信号を導出して該供給用電磁弁116をオフ状態に すると同時に、排気用電磁弁118に付勢信号を導出し て該排気用電磁弁118をオン状態とする。

【0056】従って、サックバック機構28のダイアフ ラム室96に対するパイロット圧の供給を停止し、ダイ アフラム室96内のパイロット圧の圧力が減少して零と なることにより、第2ピストン80は、第2ばね部材1 01のばね力の作用下に上昇する。なお、前記第2ピス トン80と一体的に変位する第2連結部材54bの上面 部が第2上部側弁ボデイ76aに形成された壁面128 に当接することにより、上方に対する変位が規制され る。

【0057】従って、第2ピストン80の一端部に連結 されたフック部材106が一体的に上昇することによ り、断面略円弧状のスリーブ105の先端部が円筒状可 撓性部材104の外周面の一部に係合し、該円筒状可撓 性部材104の上部側が上方に向かって引き上げられ る。このように、フック部材106のスリーブ105が 上昇して円筒状可撓性部材104の外周面の一部が引き 上げられ、前記円筒状可撓性部材104が変形して伸張 することにより、内部に形成された流通室102の容積 が増大して負圧作用が発生する。その際、流体通路34 b内の所定量のコーティング液が流通室102の増大に 伴って吸引される(図8参照)。この結果、コーティン グ液滴下装置125のノズル内に残存する所定量のコー ティング液がサックバックバルブ20側に向かって吸引 されることにより、半導体ウェハに対する液だれを防止 することができる。

【0058】パイロット圧の圧力が減少して第2ばね部 材101が上昇した際、第2位置検出センサ74bは、 前記第2連結部材54bの一端部に装着された第2磁石 72bの磁界を検知し、前記第2位置検出センサ74b

30

11

ト114 bに導入される。

【0059】なお、第1コントロールユニット114aから付勢信号を導出してオン/オフ弁26をオン状態とすると同時に、第2コントロールユニット114bから供給用電磁弁116に付勢信号を導出してオン状態とし、排気用電磁弁118に滅勢信号を導出してオフ状態とすることにより初期状態となり、半導体ウェハに対するコーティング液の滴下が開始される。

【0060】本実施の形態では、分断された流体通路34a、34bの間に変形自在な円筒状可撓性部材104を装着し、前記円筒状可撓性部材104の突条部111を固定し、該円筒状可撓性部材104の外周面の一部に係合するフック部材106のスリーブ105によって円筒状可撓性部材104の外周面を引き上げることにより、円筒状可撓性部材104を変形させて伸張させている。従って、円筒状可撓性部材104の内部に形成された流通室102の容積を増大させることにより、ノズル内に残存する所定量のコーティング液がサックバックバルブ20側に向かって吸引され、半導体ウェハに対する液だれを防止している。

【0061】このように、本実施の形態では、分断された流体通路34a、34bの中間部に円筒状可撓性部材104を装着し、円筒状可撓性部材104の内部に形成された流通室102の容積を増大させることによってコーティング液を吸引している。従って、本実施の形態では、コーティング液が流通する円筒状可撓性部材104の流通室102に段差部等が何ら形成されていないため、液溜まりの発生や塵埃等が集積することを防止することができる。

【0062】また、本実施の形態では、円筒状可撓性部 30 材104の内部に形成された流通室102の容積を増減変更させることによりサック量が設定されているため、前記サック量の範囲を広範囲に設定することができるとともに、例えば、ごく微小なサック量であっても好適に設定することができる。

[0063]

【発明の効果】本発明によれば、以下の効果が得られる。

【0064】すなわち、分断された流体通路の間に可撓性部材が変形自在に介装されているため、前記可撓性部 40材の内部に形成された流通室を増減変更させても液溜まりの発生や塵埃等が集積することを防止することができる。

【0065】また、引張部材によって前記可撓性部材の 外周面を引張することにより、前記流通室を増大させて いるため、サック量の範囲を広範囲に設定することができるとともに、ごく微小なサック量であっても好適に設定することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態に係るサックバックバルプ の縦断面図である。

【図2】図1に示すサックバックバルブを構成する容積 可変機構の部分拡大縦断面図である。

【図3】図2に示す容積可変機構の一部切欠斜視図であ 10 る。

【図4】図3に示す容積可変機構の一部断面正面図である。

【図5】図3に示す容積可変機構を構成するフック部材 が上昇して円筒状可撓性部材の内部に形成された流通室 の容積が増大した状態を示す一部断面正面図である。

【図6】図1に示すサックバックバルブが組み込まれたサックバックシステムの概略ブロック構成図である。

【図7】図1に示すサックバックバルブの動作説明図である。

20 【図8】図7の一部拡大縦断面図である。

20…サックバックバルブ

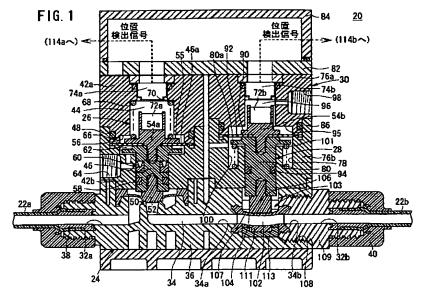
【図9】従来技術に係るサックバックバルブの縦断面図 である。

2 4 …継手部

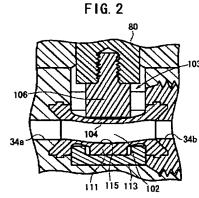
【符号の説明】

	- 1 ME 1 HP
26…オン/オフ弁	28…サックバ
ック機構	
30…弁駆動部	32a、32b
…ポート	
46、80…ピストン	5 0 …着座部
5 2 …弁体	54a,54b
…連結部材	
56、92…ダイアフラム	62…シリンダ
室	
70、101…ばね部材	72a,72b
…磁石	
74a、74b…位置検出センサ	102…流通室
103…容積可変機構	104…円筒状
可撓性部材	
105…スリーブ	106…フック
部材	
107…凹部	109…嵌合部
材	
1 1 1 … 突条部	113…固定部
材	
1 1 5 …湾曲面	

【図1】



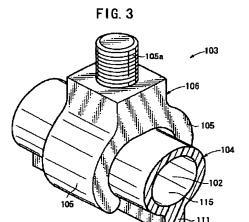
【図2】



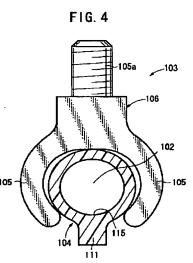
【図5】

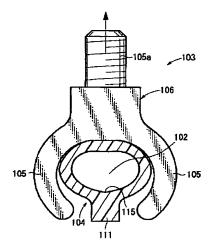
FIG. 5





【図4】





【図8】

